

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 光机电 >> 应用直接电镀和掩孔新工艺生产多层电路板

请输入查询关键词

科技频道

搜索

应用直接电镀和掩孔新工艺生产多层电路板

关键词: **电路板 电镀 掩孔 印刷电路板**

所属年份: 2002

成果类型: 应用技术

所处阶段:

成果体现形式:

知识产权形式:

项目合作方式:

成果完成单位: 北京凯迪思电子有限公司

成果摘要:

产品功能及应用领域: 印制电路板(PCB)是电子产品中的基础器件,几乎所有的电子产品中都需要PCB,例如:家电、通信产品、工业控制设备、IT硬件平台等。产品主要用于通信、航空航天、工业控制、计算机等。技术特点: 解决了镀铜时铜箔厚度均匀性、干膜贴膜中孔表面张力和贴膜密实性、多层板孔内直接电镀厚铜技术关键等问题。与国内外同类产品比较: 层数12层,最小孔径0.1mm,最小线径/线隙0.075/0.075mm; 国内其它企业: 层数10层,最小孔径0.3mm,最小线径/线隙0.12/0.12mm。成熟程度: 小批量生产; 新增总投资: 2200万元; 新增销售收入: 9680万元; 出口创汇: 200万美元; 主要竞争企业: 远东电路板有限公司、上海昆山沪士电路板有限公司。市场简要分析: 凯迪思公司现有用户500家左右,主要为通信、航空航天、计算机等领域。1998年全球PCB产值达370亿美元,预计2004年将增至500多亿美元,国内2000年北京市场电路板需求达10亿元以上,而多层板的需求在59%以上。凯迪思公司的产品已达国内先进水平,该项目的投资回收期为2.78年。 产品主要技术指标: 该公司生产的多层印制电路板层数最多达12层,最小孔径可达0.1mm,最小线径/线隙可达0.075/0.075mm,最薄板厚可达0.3mm,并且可以生产带有球型封装和盲孔埋孔的多层印制电路板。

成果完成人:

[完整信息](#)

行业资讯

- 塔北地区高精度卫星遥感数据处理
- 综合遥感技术在公路深部地质...
- 轻型高稳定度干涉成像光谱仪
- 智能化多用途无人机对地观测技术
- 稳态大视场偏振干涉成像光谱仪
- 2001年土地利用动态遥感监测
- 新疆特克斯河恰甫其海综合利...
- 用气象卫星资料反演蒸散
- 天水陇南滑坡泥石流遥感分析
- 综合机载红外遥感测量系统及...

成果交流

推荐成果

- [容错控制系统综合可信性分析...](#) 04-23
- [基于MEMS的微型高度计和微型...](#) 04-23
- [基于MEMS的载体测控系统及其...](#) 04-23
- [微机械惯性仪表](#) 04-23
- [自适应预估控制在大型分散控...](#) 04-23
- [300MW燃煤机组非线性动态模型...](#) 04-23
- [先进控制策略在大型火电机组...](#) 04-23
- [自动检测系统化技术的研究与应用](#) 04-23
- [机械产品可靠性分析--故障模...](#) 04-23

Google提供的广告

